

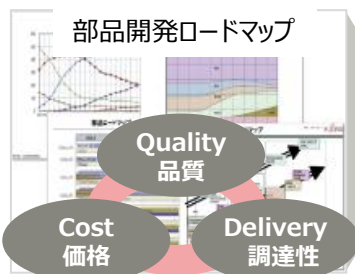
# 設計支援サービス

長年のICT機器開発における電子部品\*1採用で培った技術とノウハウでお客様のQCD向上に貢献いたします。

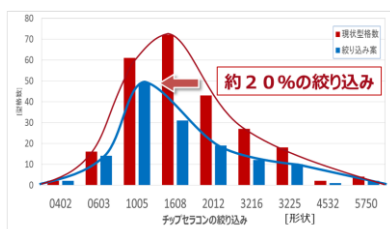
\*1:回路部品(抵抗,コンデンサ等), 半導体部品(LSI,個別半導体,FPGA,メモリ), 機構部品(コネクタ,ケーブル), 電源モジュール, 光/電気伝送モジュール

## 部品標準化支援

市場トレンドに合った旬な部品を選定。  
部品点数の絞り込み、EOL\*2リスク回避。



- トレンド部品の適用
- EOLリスクの低減
- QCD最適化



採用部品点数絞り込み例

\*2: EOL: End Of Life (生産終息通知)

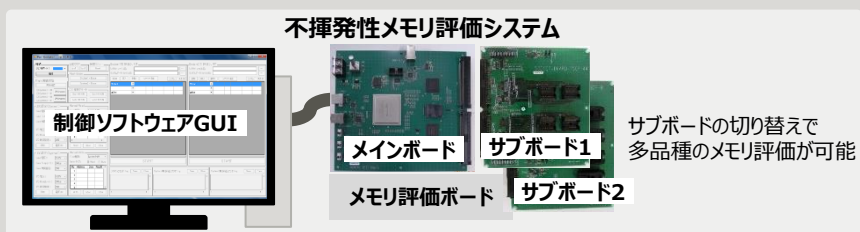
## 部品ライフサイクルマネジメント

EOLリスク調査、EOL代替品調査  
供給難部品の代替品調査  
PCN\*3, 4M変更対応

\*3: PCN: Product Change Notification

## 部品評価環境構築、評価ボード試作

特性測定効率化、評価環境構築の低コスト化



商品・サービスについてのお問い合わせは  
NTTデバイスクロステクノロジー株式会社 設計支援サービス統括部  
<https://www.ntt-innovative-devices.com/nxtec/>

## 設計品質検証、リスク分析

過去障害経験からFMEA\*4

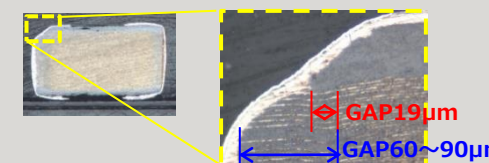
\*4: FMEA: Failure Mode and Effect Analysis

## 部品評価

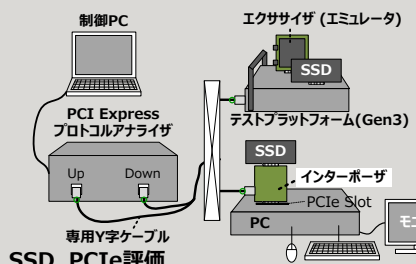
機能/特性評価  
信頼性/実装性評価



メモリIC評価



断面観察による構造解析



SSD PCIe評価

部品単体機能/特性評価

## ベンチマーク

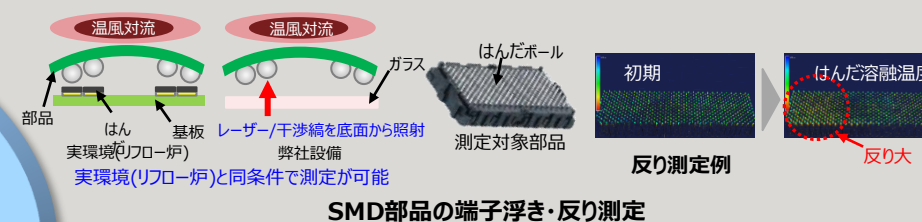
複数部品ベンダ製品比較  
QCD最適部品選定

部品選定

検証・評価

評価環境構築

障害対応



SMD部品の端子浮き・反り測定

## 障害要因切り分け

再現調査、再現条件明確化



光出力波形

光受信感度

電気出力波形

不具合部位切り分け調査例

## 原因究明、対策決定

原因と対策検討、FTA\*5、対策効果確認



FTA例

各種解析

イオンマイグレーション

ウイスカ

障害事例 (物理解析結果)

\*5: FTA: Fault Tree Analysis